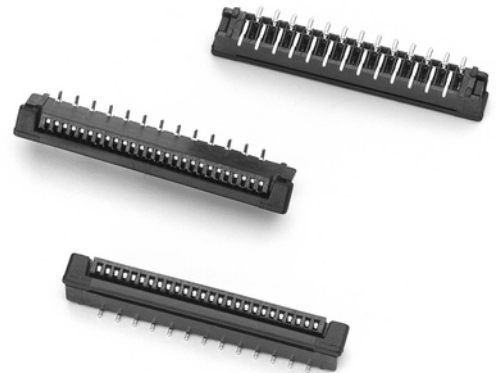


5580

SMT ZIF-Stecker RM 0,50mm, stehend SMT ZIF-Connectors, 0.50mm Pitch, Vertical

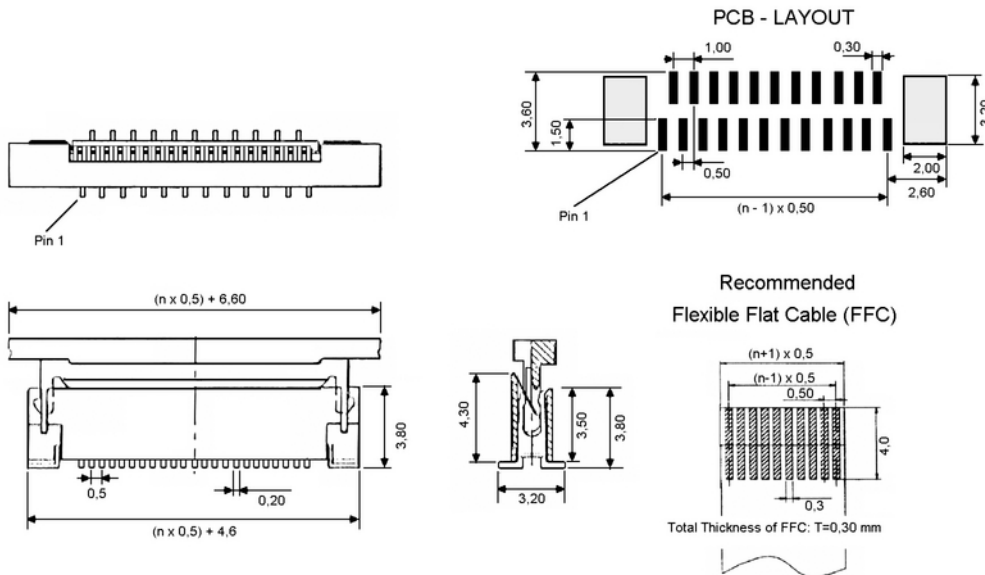
Technische Daten / Technical Data

| | |
|-----------------------|---|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Contact Material | Copper alloy |
| Kontaktfläche | Zinn über Nickel |
| Contact Surface | Tin plated over nickel |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Solderability | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Contact Resistance | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 100MΩ |
| Insulation Resistance | > 100MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 250V _{AC} |
| Test Voltage | 250V _{AC} |
| Nennspannung | 50V _{AC} |
| Voltage Rating | 50V _{AC} |
| Nennstrom | 0,5A |
| Current Rating | 0,5A |
| Temperaturbereich | -20°C ... +85°C |
| Temperature Range | -20°C ... +85°C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |
| Processing | Reflow soldering |



© W+P PRODUCTS

Passende Flex-Kabel:
Mate with Flexible Flat Cables: **599**



Series

5580

Contacts*

34

04-50

Packaging*

ST

ST
TR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad
TR Tape & Reel / Tape & Reel

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

